

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2025-027

杭州晶华微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

1、被担保人：深圳芯邦智芯微电子有限公司（以下简称“智芯微”），系杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公司智芯微提供担保额度不超过人民币 8,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额为 0 万元。

3、本次担保无反担保。

4、本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过生效后生效。

一、担保情况概述

公司全资子公司智芯微系上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“上海华虹”）和华虹半导体（无锡）有限公司（以下简称“无锡华虹”）的客户，向上海华虹和无锡华虹购买集成电路制造相关产品或服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。

为满足公司及子公司的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为智芯微就其向上海华虹、无锡华虹采购产品或服务之延期付款提供不超过人民币 8,000 万元（其中对上海

华虹不超过 6,000 万元，对无锡华虹不超过 2,000 万元）的担保额度，并授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。上述担保事项的主债权确定期间为自本次董事会审议通过之日起三年。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。具体内容以实际签署的担保函为准，公司与上海华虹和无锡华虹不存在关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳芯邦智芯微电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MADYFLKY6H
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：纪臻
- 5、注册资本：3300 万元人民币
- 6、成立日期：2024 年 09 月 11 日
- 7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）12 栋 601
- 8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：无。
- 9、股权结构：公司持有智芯微 100% 股权
- 10、信用状况：不属于失信被执行人
- 11、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
- 12、与公司的关联关系：公司全资子公司
- 13、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务情况	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年第一 季度 (未经审计)
资产总额	4,353.70	5,251.15
负债总额	1,105.22	1,969.53

资产净额	3,248.48	3,281.62
营业收入	1,110.20	890.42
净利润	-51.52	33.13
扣除非经常性损益后的净利润	-70.74	32.94

注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保文件的主要内容

智芯微向供应商上海华虹和无锡华虹购买集成电路制造相关产品或服务，公司拟为智芯微在主债权确定期间与上海华虹和无锡华虹发生的采购进行担保，同意当智芯微延迟或无法履行上述事项的付款义务时，承担合计不超过人民币 8,000 万元（其中对上海华虹不超过 6,000 万元，对无锡华虹不超过 2,000 万元）的连带保证责任。主债权确定期间为自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容以实际签署的担保函为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保系根据全资子公司实际业务需要，为满足全资子公司日常经营需求而进行的，有利于支持其业务顺利开展。被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，信用情况良好，具备一定的偿债能力和抗风险能力。

同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、审议情况及审核意见

（一）审议情况

公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（二）董事会意见

公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、

法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：本次担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于确保公司生产经营持续稳健发展而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保发生前，公司及子公司无对外担保，本次担保发生后，公司对子公司的担保总额不超过人民币8,000万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32%。公司及子公司不存在为第三方提供担保，不存在逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年5月16日